

# SID

Werk: Rot am See

Artikel:

755

ML2

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

03.04.2017



Materialtext

Mat. Nr.

µm

Aufbau

Prozessaufbau

A-RS Pyralux AP8525E 305x457mm 0.050mm... 50200050

18

VS

50

RS

18



A00

Dicke nach Verpressen

A00:

110 µm

Tol+:

50 µm

Tol-:

50 µm

Dmax:

160 µm

Dmin:

60 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

170 µm

Tol+:

50 µm

Tol-:

50 µm

Dmax:

220 µm

Dmin:

120 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

86 µm

Version 1.2.16.24

© Würth Elektronik

Achtung bei PCBs ohne DK-Bohrungen: Hier wird eine Enddicke von ca. 0,115mm erreicht